

半导体 Batch C



配有中置机器人的柔性半导体制造湿法工作平台

模块化与定制型

应用领域

- 半导体、MEMS、LED、OLED、光电子、有机电子、医疗
- FEOL（前道工艺）与 BEOL（后道工艺）中的所有湿化学工艺应用

特点和优势

- 软件可灵活自由配置确保工艺的高度灵活性与完善的过程分析
- 先进的排程和产出模拟
- 兼具标准化与高度定制化的设备系统
- 适用从 4" 到 8" 的各种基材工艺
- 中置 6 轴机器人
- 适用于标准花篮或无花篮工艺的机械搬运系统
- 柔性进/出料台设计
- 模块化设计使得无论是细小的调整或者重大的定制需求都更加便捷
- 电控柜已集成至设备主体内部，减少占地面积并可快速安装调试
- 系统化大模块分区减少了现场安装工作量且适于空运或海运
- 按照 SEMI 标准制造
- 机台内洁净室等级可达到 ISO class 3
- 维护服务友好型设计





进料台/出料台



不锈钢工艺槽



Batch C 技术数据

工艺性能

- 在硅片内、批次内与每次运行间均可达到高度均匀的工艺结果
- 适用于 SOM/SPM/SOPM、BOE、纯水清洗、HCl、HF、HNO₃、SC1、O₃ 清洗等工艺
- 适用于 Marangoni 干燥、氢氟酸/臭氧干燥、热水慢提干燥、旋转式干燥

生产过程的可靠性

- E-MTBFp > 500h
- uptime > 96%
- 先进的工艺与流程控制和生产制造--FDC、R2R 控制、EHM、实时数据收集

尺寸

宽度*	高度 (包括层流风机过滤机组)	长度
2000 mm	2900 mm	5000

* 设备宽度可针对特殊应用进行调整

选项

- 可扩展的加进料/出料缓冲站
- 工艺槽的每一种化学品配有独立的储液罐负责从外部或中央化学品供应系统进行自动补液
- 桶装化学品供给系统